

2025年3月期 第3四半期（2024年10月～12月） 東京エレクトロン 決算説明会

2025年2月6日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）

将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、新型コロナウイルス感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

第3四半期 連結決算の概要

2025年2月6日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー
川本 弘



損益状況（四半期）

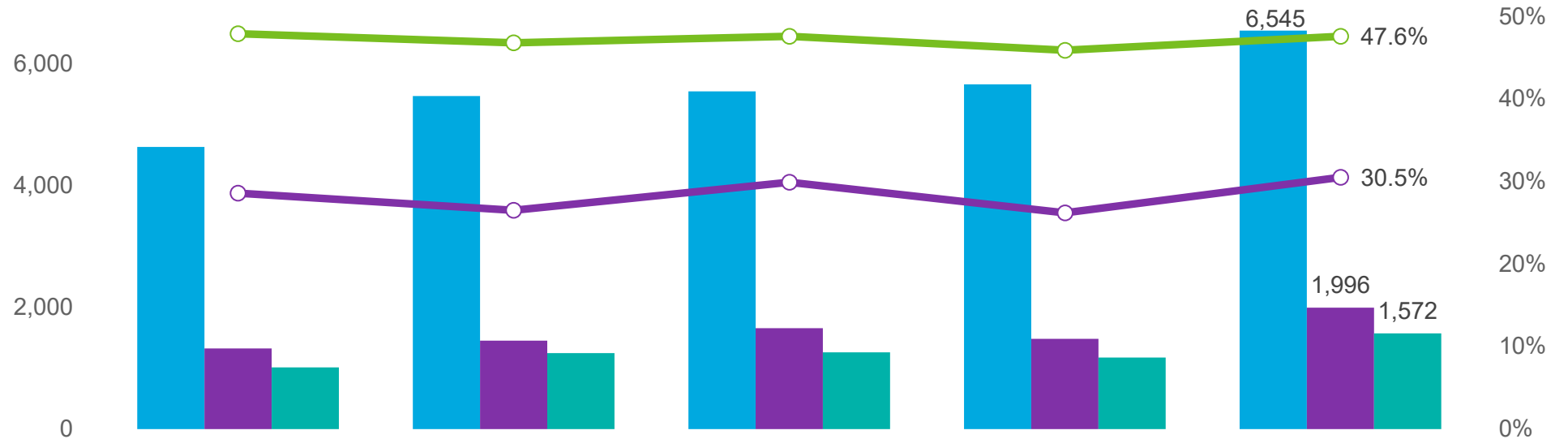
（億円）

	FY2024		FY2025			vs. Q2 FY2025	vs. Q3 FY2024
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		
売上高	4,636	5,472	5,550	5,665	6,545	+15.5%	+41.2%
売上総利益	2,221	2,561	2,640	2,599	3,117	+19.9%	+40.4%
売上総利益率	47.9%	46.8%	47.6%	45.9%	47.6%	+1.7pts	-0.3pts
販管費	896	1,108	982	1,117	1,121	+0.3%	+25.1%
営業利益	1,324	1,452	1,657	1,481	1,996	+34.7%	+50.7%
営業利益率	28.6%	26.5%	29.9%	26.2%	30.5%	+4.3pts	+1.9pts
税金等調整前当期純利益	1,344	1,578	1,672	1,536	2,001	+30.3%	+48.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,015	1,249	1,261	1,177	1,572	+33.6%	+54.9%
研究開発費	497	584	534	620	618	-0.4%	+24.1%
設備投資額	318	329	239	533	502	-5.7%	+57.8%
減価償却費	138	153	132	145	160	+10.8%	+16.4%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況（四半期）

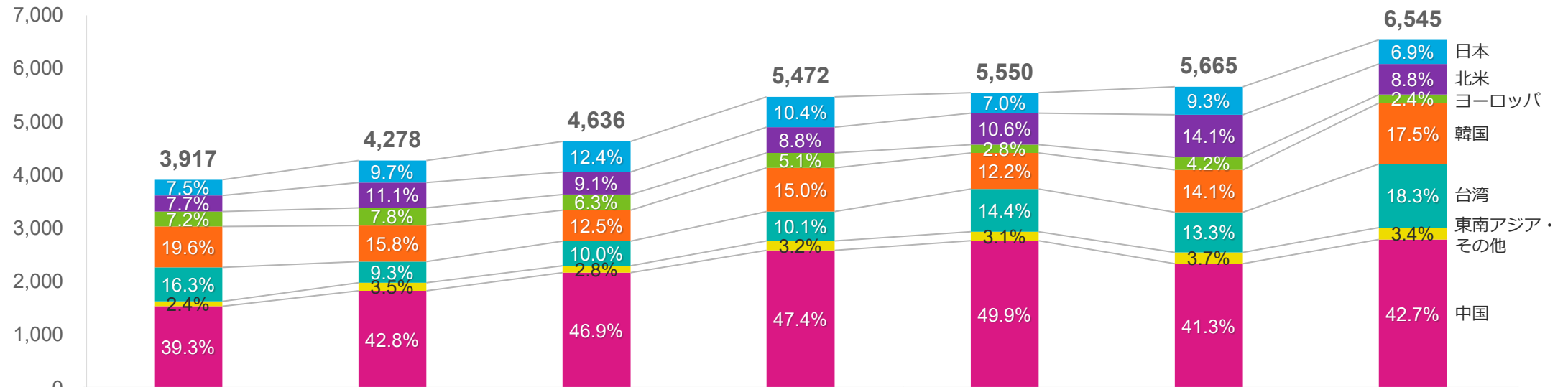
(億円) 8,000



	FY2024		FY2025		
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
■ 売上高	4,636	5,472	5,550	5,665	6,545
■ 営業利益	1,324	1,452	1,657	1,481	1,996
■ 親会社株主に帰属する 当期純利益	1,015	1,249	1,261	1,177	1,572
○ 売上総利益率	47.9%	46.8%	47.6%	45.9%	47.6%
○ 営業利益率	28.6%	26.5%	29.9%	26.2%	30.5%

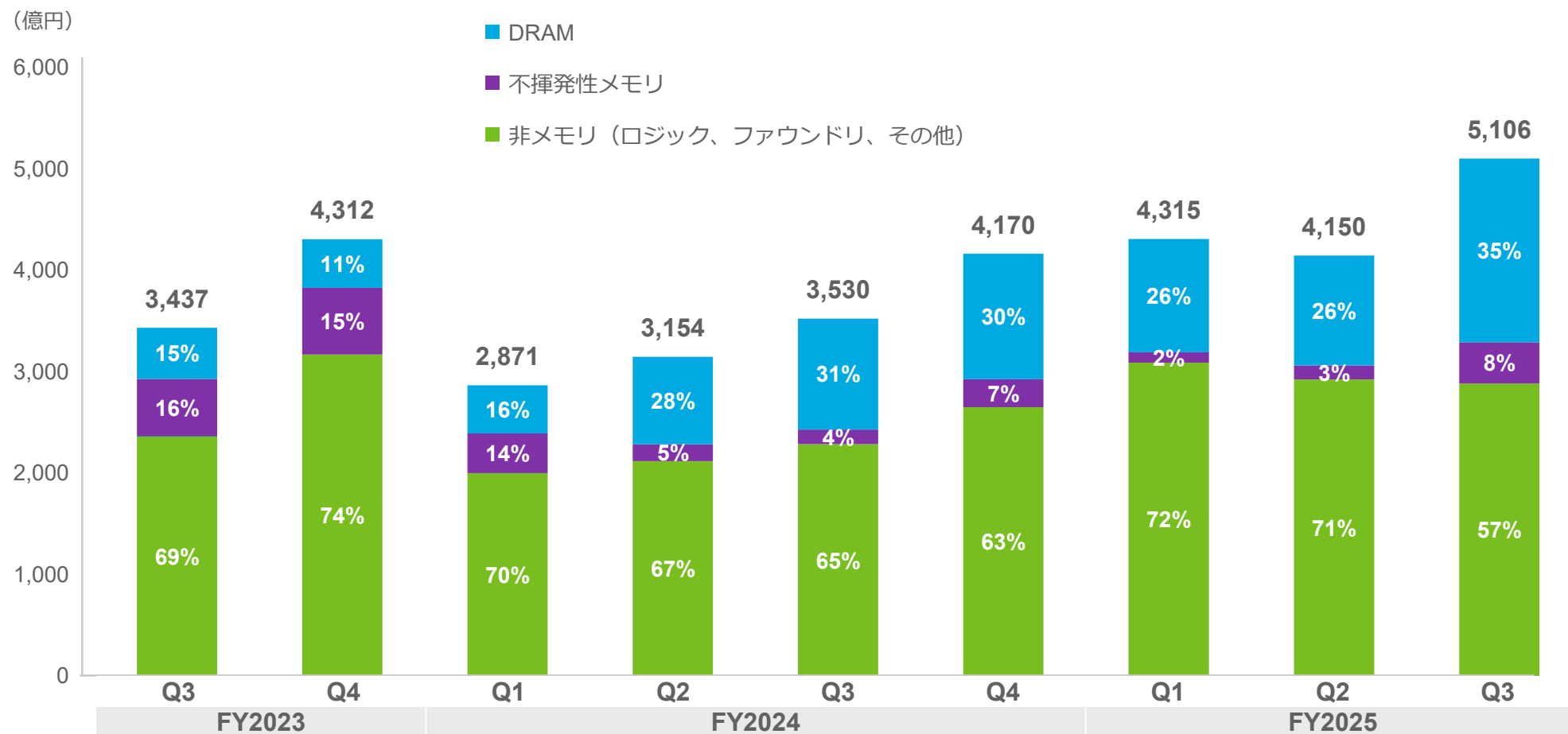
地域別売上高構成比 (FY2024 Q1~FY2025 Q3)

(億円)



	FY2024				FY2025		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
日本	295	412	574	567	385	526	453
北米	301	474	421	483	590	799	577
ヨーロッパ	281	335	294	281	155	238	157
韓国	767	674	582	820	678	795	1,145
台湾	639	399	463	552	800	753	1,193
東南アジア・その他	92	151	127	175	170	212	223
中国	1,539	1,829	2,172	2,591	2,770	2,339	2,794

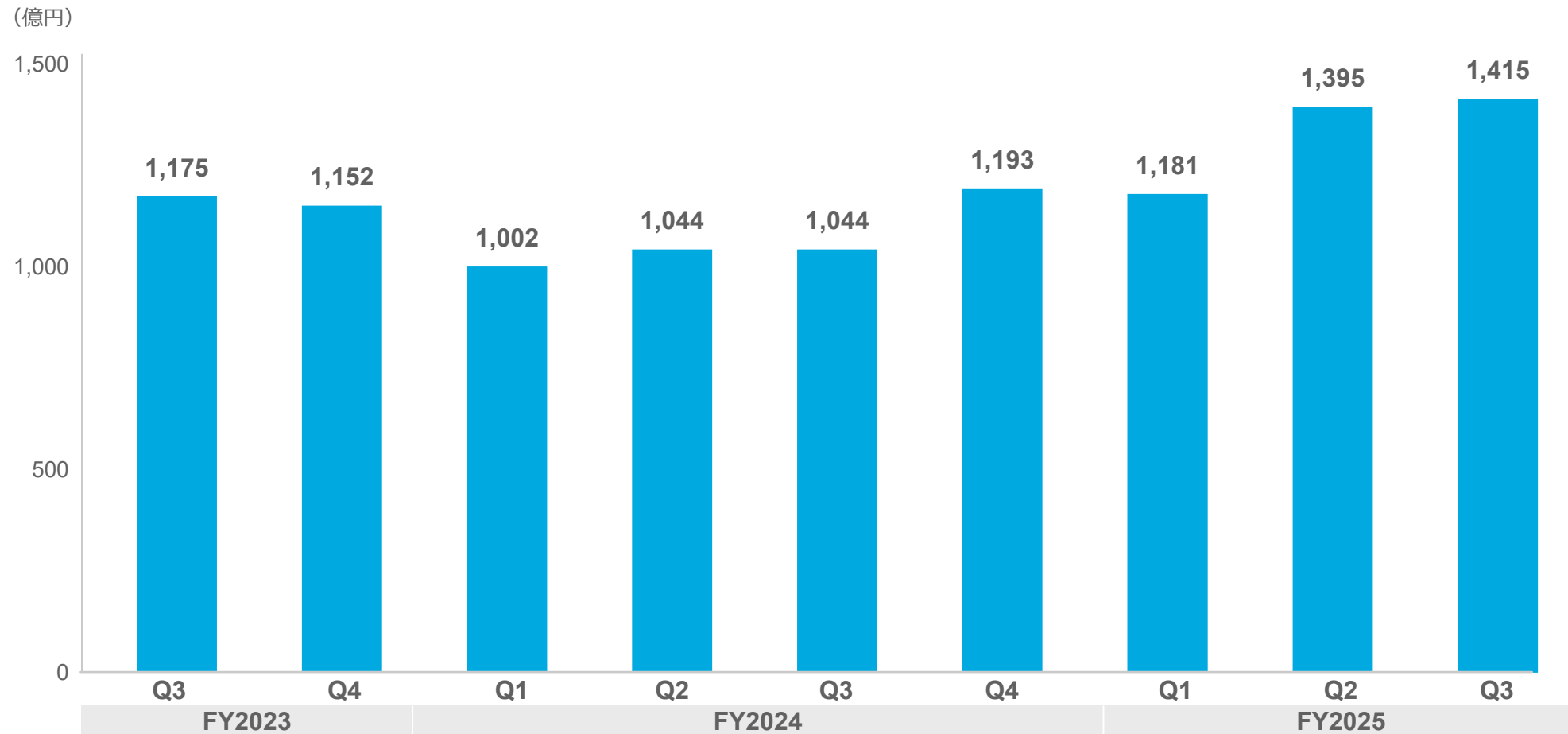
SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



*1 SPE：半導体製造装置

*2 グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

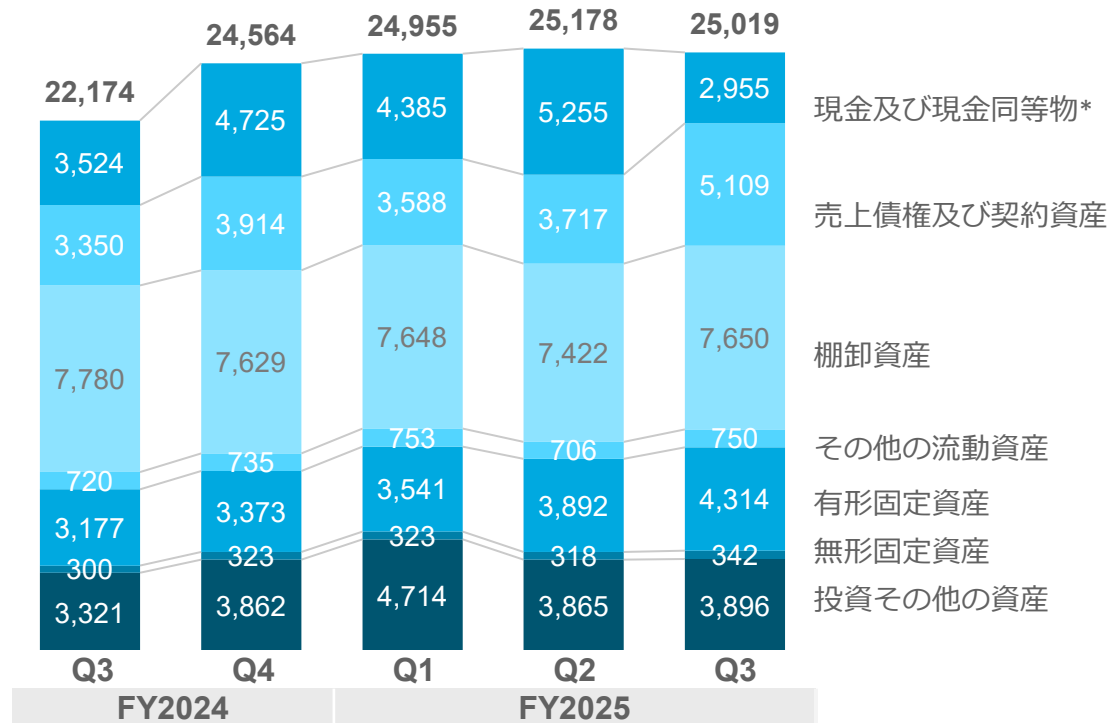
フィールドソリューション売上高（四半期）



貸借対照表（四半期）

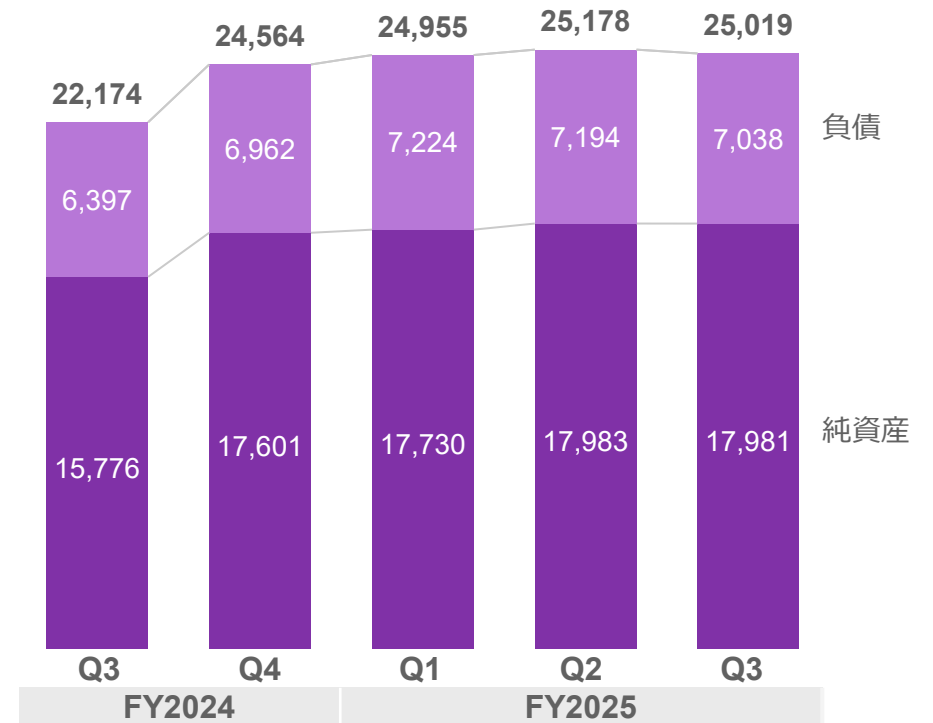
資産

(億円)



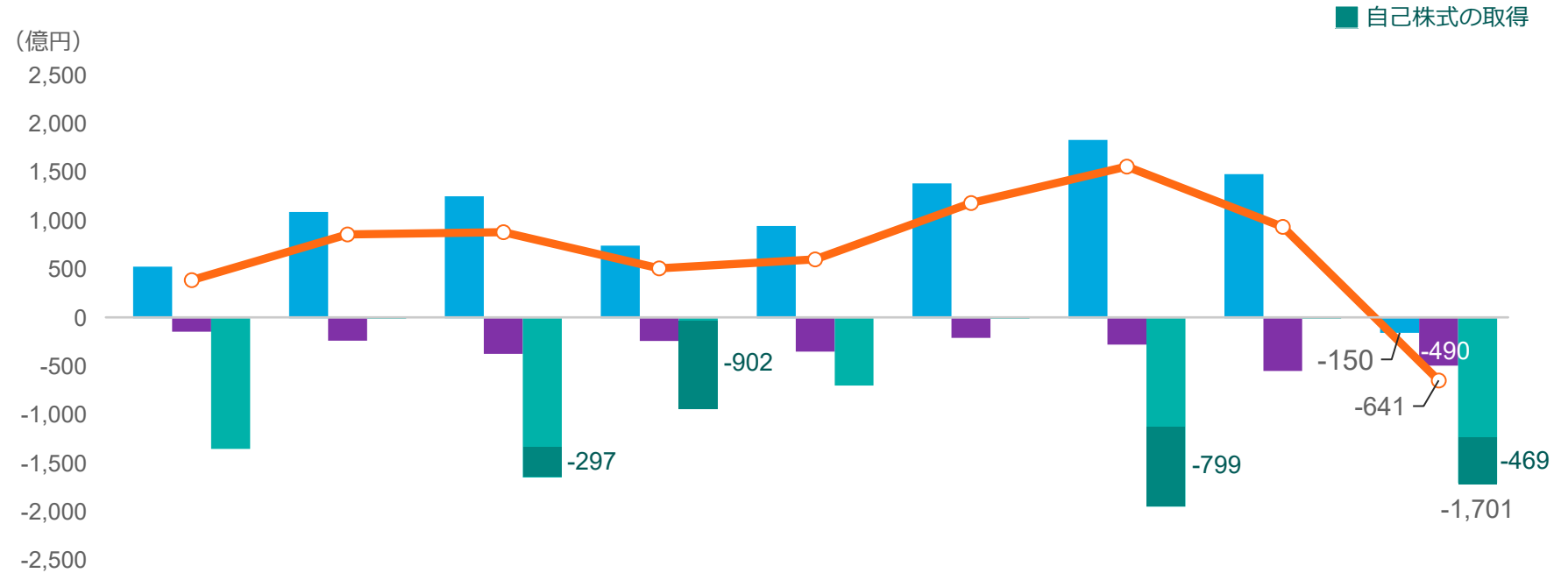
負債・純資産

(億円)



*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

キャッシュ・フロー（四半期）



	FY2023		FY2024				FY2025		
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
■ 営業キャッシュ・フロー	532	1,096	1,257	748	950	1,390	1,837	1,486	-150
■ 投資キャッシュ・フロー* ¹	-138	-231	-368	-234	-344	-203	-273	-544	-490
■ 財務キャッシュ・フロー	-1,346	-5	-1,641	-908	-693	-6	-1,944	-6	-1,701
○ フリーキャッシュ・フロー* ²	393	865	888	514	606	1,187	1,564	941	-641
■ 手元資金残高* ³	3,874	4,731	4,010	3,626	3,524	4,725	4,385	5,255	2,955

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

自己株式の取得状況

■ 2024年12月31日現在

- 取得した株式の総数 2,024,200 株
- 株式の取得価額の総額 46,951,329,991 円

ご参考

■ 2025年1月31日現在（取得終了）

- 取得した株式の総数 2,901,300 株
- 株式の取得価額の総額 69,999,869,491 円

(2024年11月12日開催の取締役会における決議の内容)

- 取得対象株式の種類 当社普通株式
- 取得し得る株式の総数 350 万株（上限） ※自己株式を除く発行済み株式総数に対する割合 0.8%
- 株式の取得価額の総額 700 億円（上限）
- 取得する期間 2024年11月13日～2025年1月31日

事業環境および業績予想

2025年2月6日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



事業環境（2025年2月時点でのWFE市場の見方）

- **CY2024：\$110B程度で着地。期初想定を\$10B上回る**
 - 中国顧客における納期の前倒しに加え、AIサーバー向け投資が活況
- **CY2025：前年同等の\$110B程度と予想**
 - 車載やパワー半導体投資、中国新興メーカーの投資は一服
 - AIサーバー向け需要に伴う最先端ロジックとHBM*1が投資を牽引
- **CY2026: 二桁成長を期待**

大容量・超高速・高信頼性・低消費電力の実現に向け、
スケーリングとヘテロジニアスイнтеグレーションの2軸で技術革新が進展。
GAA*2・Backside PDN*3・HBMやテスト工程など、TELの事業機会は拡大

*1 HBM (High Bandwidth Memory)

*2 GAA (Gate All Around)

*3 Backside PDN (Power Delivery Network)

: 高帯域幅DRAM

: トランジスタのチャネル全面をゲートで覆った構造

: 電源供給配線をウェーハの裏面に配置する構造

FY2025 Q3 事業進捗

- 売上・利益等、すべての指標において計画を達成
 - Q3：売上高 6,545億円、営業利益 1,996億円、営業利益率 30.5%
 - CYベースでの成長率は+26%となり、市場成長を大きくアウトパフォーム
- 戦略製品によるPOR^{*1}獲得・開発評価も順調に進捗
 - 極低温エッチング装置：NAND チャンネルホール向け量産採用決定
 - 枚葉成膜装置 Episode™ 1：ロジック Backside PDN向け量産採用決定
- 新製品を2機種リリース。SAM^{*2}の拡大を目指す
 - PVD装置 LEXIA™ -EX
 - スループット20%向上、フットプリント40%削減、CO₂排出量14%削減
 - レーザー剥離装置 Ulucus™ LX
 - 純水使用量 90%以上削減、ウェーハ当たりの有効チップ数増加、剥離後のシリコンウェーハを再利用する技術も開発中

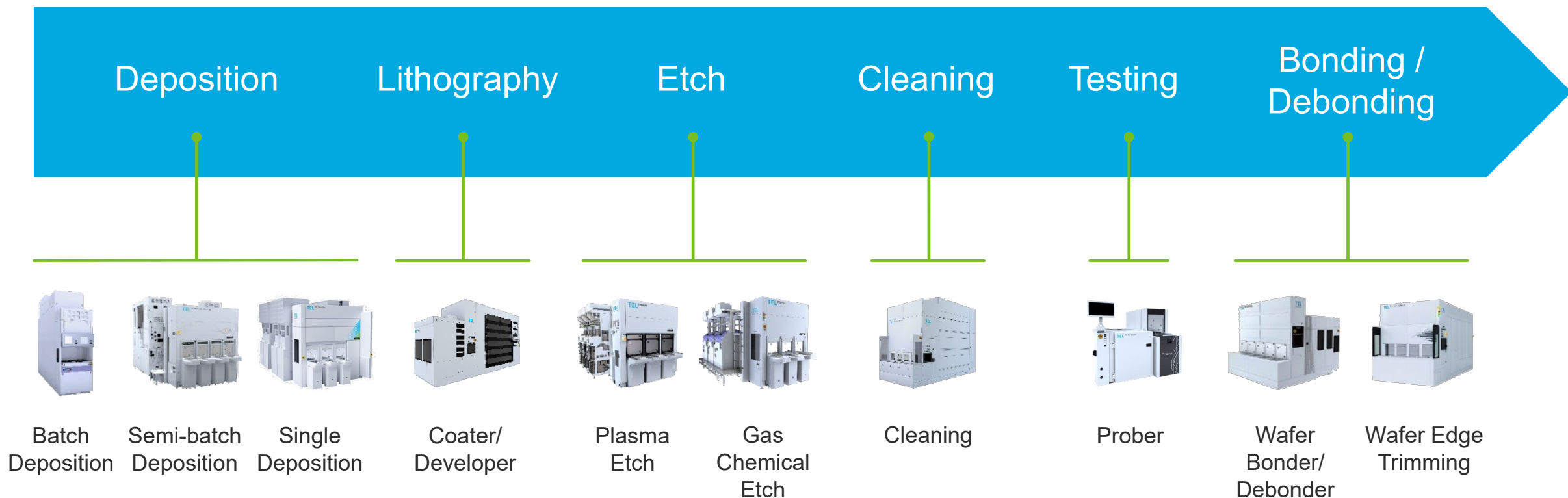
*1 POR (Process of Record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

*2 SAM (Served Available Market) : 参入市場の規模

拡大する事業機会：豊富な製品ラインアップ

Front-end

3D Integration



2025年2月26日のIR Dayにて、それぞれの成長戦略をご説明

東京エレクトロン宮城 生産新棟計画

- 延床面積：約88,600m²（予定）
* 付帯設備エリア除く
- 構造：鉄骨造/全免震構造
地上5階建て
- 建設費用：約1,040億円
- 用途：エッチング装置の生産

生産新棟（2027年夏 竣工予定）



物流の自動化や製造工程の機械化を取り入れ、高い生産能力と高品質で
高効率な製造ラインを構築し、次世代生産（Smart-Production）を実現

FY2025 業績予想

FY2025 業績予想

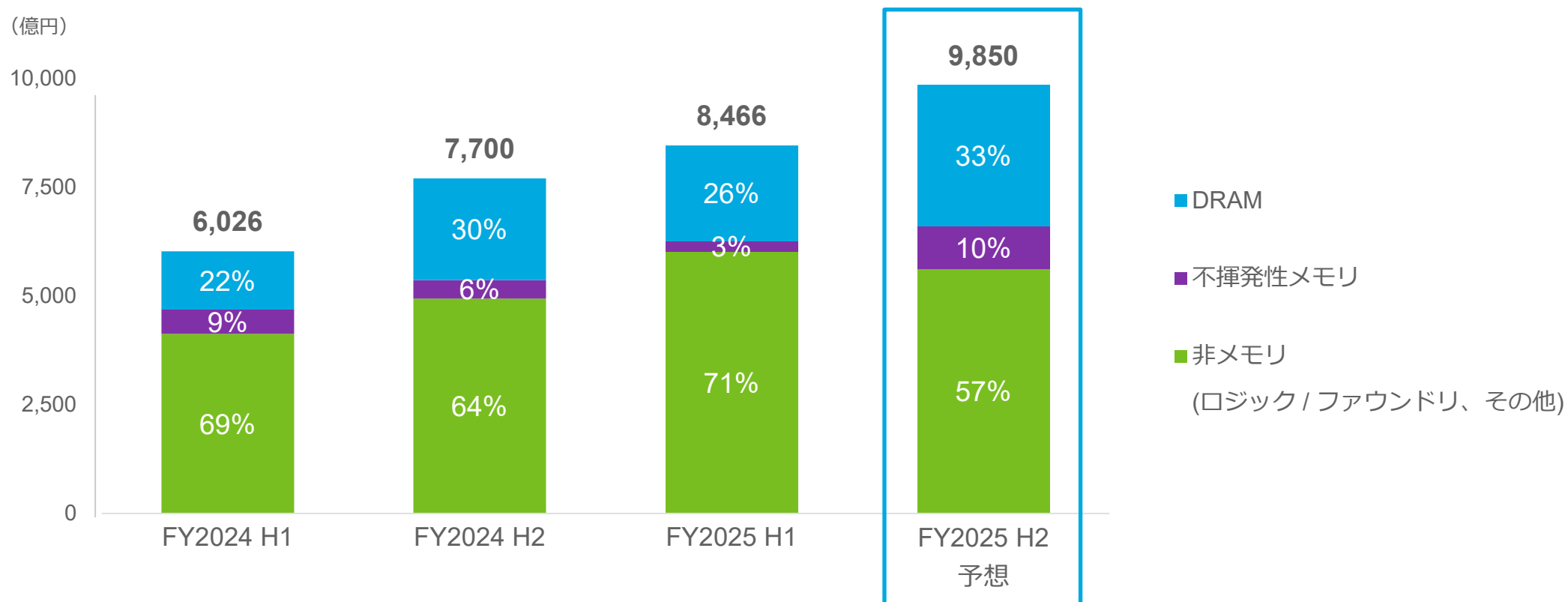
(億円)

	FY2024 (実績)	FY2025			
		H1 (実績)	H2 (予想)	通期 (予想)	通期 YoY
売上高	18,305	11,216	12,783	24,000	+31.1%
売上総利益	8,302	5,239	6,050	11,290	+36.0%
売上総利益率	45.4%	46.7%	47.3%	47.0%	+1.6pts
販管費	3,740	2,100	2,389	4,490	+20.1%
研究開発費	2,028	1,154	1,386	2,540	+25.2%
研究開発費以外の販管費	1,711	945	1,003	1,950	+14.0%
営業利益	4,562	3,139	3,660	6,800	+49.0%
営業利益率	24.9%	28.0%	28.6%	28.3%	+3.4pts
税金等調整前当期純利益	4,734	3,208	3,701	6,910	+46.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	3,639	2,439	2,820	5,260	+44.5%
1株当たり当期純利益 (円)	783.75	528.67	-	1,142.47	+358.72

FY2025通期の売上成長率は30%超。市場成長を大きくアウトパフォーム

FY2025 SPE新規装置売上予想

アプリケーション別売上構成比



グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

FY2025H2は過去最高の半期売上を予想

FY2025 研究開発費・設備投資計画

新開発棟

成膜装置、エッチング装置、コーポレート開発



山梨県富士川町
2023年7月 竣工

東北生産・物流センター

成膜装置



岩手県奥州市
2025年秋 竣工予定

新開発棟

コート/デベロッパ、洗浄装置、ボンディング装置



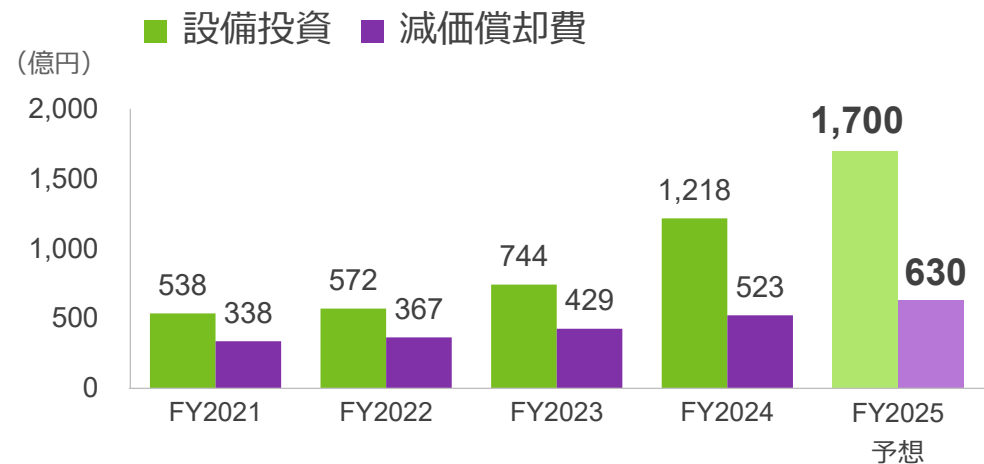
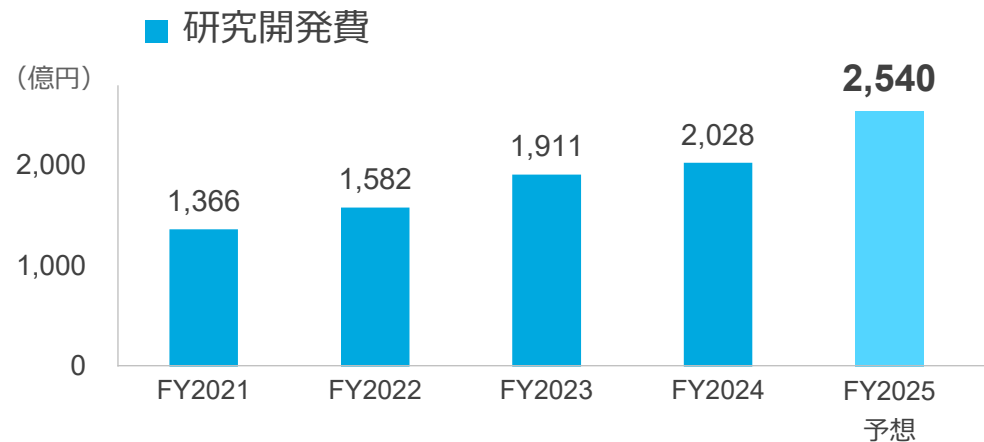
熊本県合志市
2025年夏 竣工予定

新開発棟

エッチング装置



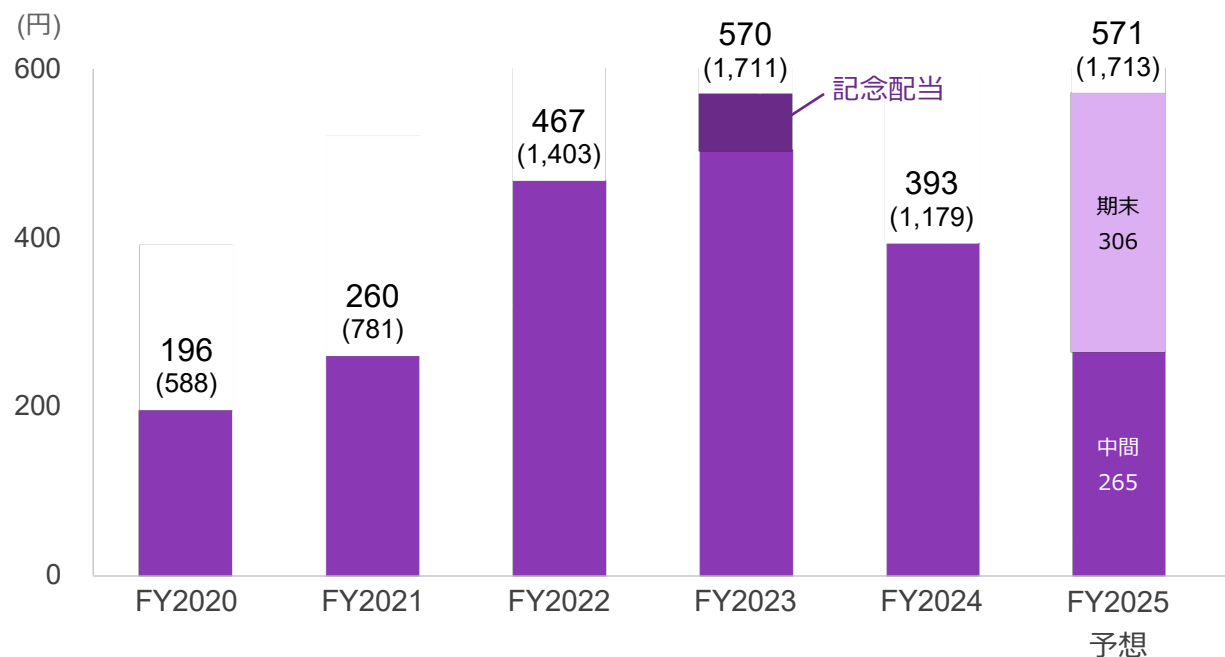
宮城県黒川郡
2025年春 竣工予定



さらなる成長を見据え、積極的な研究開発・設備投資を継続

FY2025 配当予想

1株当たり配当金



当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

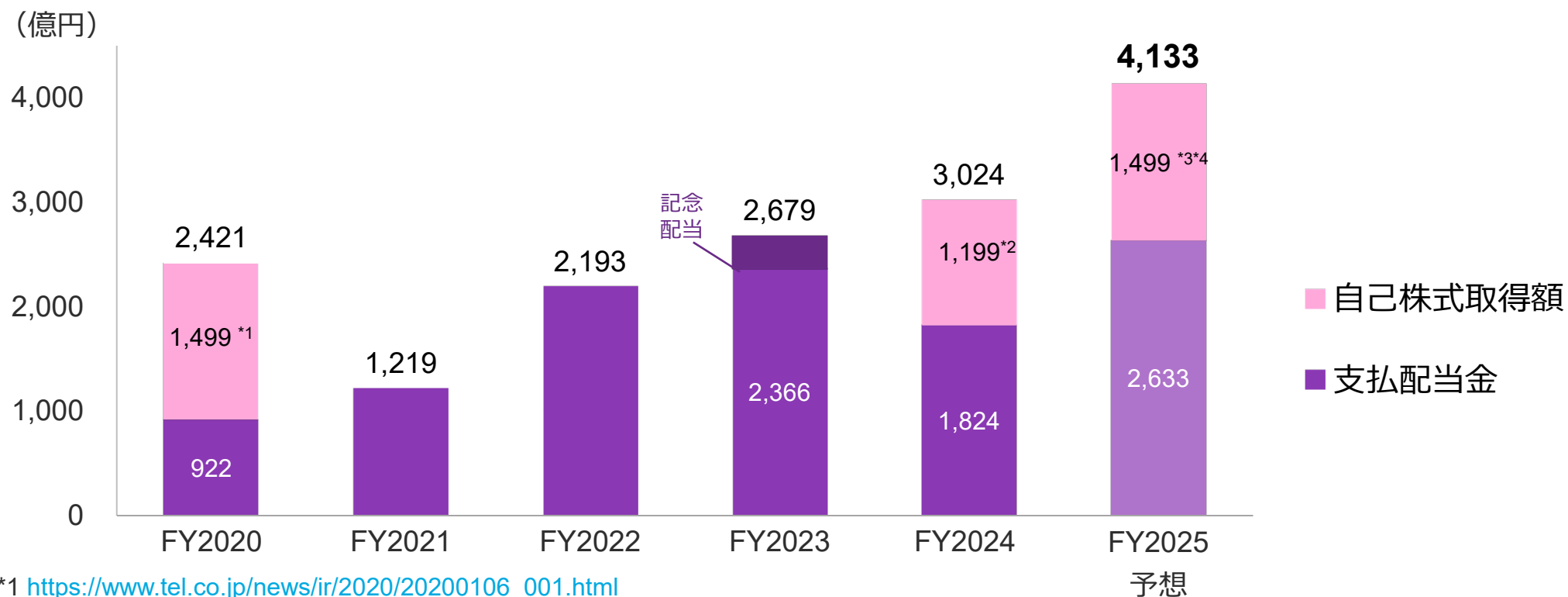
自己株式の取得：機動的に実施を検討

*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

- FY2020～2023の1株当たり配当額は、FY2020の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- FY2023には60周年記念配当が含まれます。
- 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

2023年4月1日付で普通株式1株を3株に分割。通期配当は571円を予定

総還元額



*1 https://www.tel.co.jp/news/ir/2020/20200106_001.html

*2 https://www.tel.co.jp/news/ir/2023/sb15um000000009e-att/20231002_001.pdf

*3 https://www.tel.co.jp/news/ir/2024/tln2lq00000000c0-att/20240701_001.pdf

*4 https://www.tel.co.jp/news/ir/2025/kb8thq00000000ot-att/20250203_001.pdf

自己株式取得と合わせ、過去最高の総還元額を見込む

TEL

TOKYO ELECTRON